

上海柘中集团股份有限公司

关于国晶（嘉兴）半导体有限公司股权交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月9日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于签订国晶（嘉兴）半导体有限公司股权收购协议的议案》，董事会同意向金瑞泓微电子（衢州）有限公司（以下简称“金瑞泓微电子”）转让公司持有的国晶（嘉兴）半导体有限公司（以下简称“国晶半导体”，现已更名为“金瑞泓微电子（嘉兴）有限公司”）80,000万元出资额。交易完成后，公司对国晶半导体的股权及其他权益一并转让。具体内容详见公司披露的《关于签订国晶（嘉兴）半导体有限公司股权收购协议的公告》（公告编号：2022-20）。

根据公司与金瑞泓微电子、上海康峰投资管理有限公司、国晶半导体签署的《关于国晶（嘉兴）半导体有限公司之股权收购协议》，公司原对国晶半导体80,000万元出资额对应的投资款金额为81,600万元，公司已实际缴付的国晶半导体35,000万元出资额向金瑞泓微电子转让价款为35,259.27万元。公司已于2022年3月10日收到金瑞泓微电子支付的第一期股权转让价款17,629.635万元；并于近日收到了金瑞泓微电子支付的第二期股权转让价款17,629.635万元。公司对国晶半导体80,000万元出资额尚未实际缴付的46,600万元出资款由金瑞泓微电子承担出资义务。

公司将根据相关法律法规的规定对交易进展情况履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二二年五月十一日